

2013年2月5日

チップマウンタ用新型テープフィーダ「SLフィーダ」を開発 —作業効率を向上し、高い実装品質を提供—

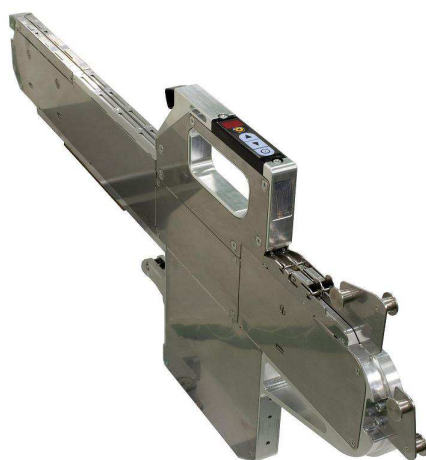
株式会社日立ハイテクノロジーズ（執行役社長：久田 眞佐男／以下、日立ハイテック）は、作業効率・実装品質・供給部品安定性を大幅に向上した、チップマウンタ（電子部品実装機）の新型テープフィーダ「Super Loading (SL)フィーダ」を開発し、2013年2月より販売を開始しました。

今までチップマウンタでは、部品供給テープを補給する際、作業者がスプライシング（接合用）テープで補給テープを繋ぐ作業を行って来ました。今回開発したSLフィーダは、所定位置にセットすることで自動ローディングでき、また部品供給時に限らず、あらかじめ交換用のテープ部品をセットしておくことができます。これにより、作業時間の短縮と作業効率の向上、そして作業技術に左右されない実装品質の向上、スプライシングテープ不使用によるコスト低減を実現し、「いつでも」「誰でも」「クイックセット」による部品供給を可能にしました。

さらに、SLフィーダは、キャリアテープとともにカバーテープが送り出されて廃棄される、カバーテープ新処理方式を採用することにより、カバーテープ回収作業が不要となり、紙ケバ発生の低減と部品送り精度の安定化を実現することで、オペレータの作業性向上、部品吸着の安定化、実装品質向上に貢献します。

SLフィーダは、日立ハイテックの100%子会社である、株式会社日立ハイテックインストルメンツ（埼玉県熊谷市、社長：光用 豊）が開発・製造し、同社が製造している高速モジュラーマウンタ「Σシリーズ」・「GXHシリーズ」に搭載が可能です。日立ハイテックがチップマウンタとともに、スマートフォン・タブレットPCなど各種電子機器メーカーや基板製造サービスメーカー向けに販売いたします。

日立ハイテックは、今回開発したSLフィーダとチップマウンタをセットでご提供することにより、お客様のさらなる省人化・自動化へのニーズに対応するとともに製品の付加価値を高め、より一層の顧客満足度向上に取り組んでまいります。



Super Loading フィーダ

■お問い合わせ先

実装システム営業本部 実装システム一部

担当：前田、矢野

TEL：048-506-6166

■報道機関お問い合わせ先

CSR本部 コーポレート・コミュニケーション部

担当：武内、松本

TEL：03-3504-7760